

「基礎講座 設計の現状と未来 - 教育から現場へ - 」

開催期日：平成30年 6月 8日(金)

申込締切：平成30年 6月 1日(金)

製品設計の現場では、20年以上前から3D-CADが本格導入され、今では製造業の多くが3次元設計による製品開発を行っています。一方、製造業のグローバル化が進展する中で、国内工場の強みをさらに強化する、ものづくりの国内回帰もより鮮明になっています。このような状況の中、日本の製造業が世界的な競争を勝ち抜くためには、高付加価値品の設計と、開発から生産までの効率化が望まれています。しかしながら、これらの目的を達成するためには、現状の3Dモデルの活用だけでは不十分であり、製品設計の技術的な進展に加え、複雑化する設計技術に対するエンジニアの育成も課題となっています。今回の講習会では、CAD設計の歴史から最新の3D製図規格、製品設計の具体的事例をご紹介しますとともに、大学および企業の設計現場における教育・育成方法についてもご紹介します。

日 時：平成30年6月8日(金) 10時00分～17時25分

会 場：中央大学 後楽園キャンパス 2号館2階 2215室および2221室 (〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27)

* 東京メトロ丸ノ内線・南北線『後楽園駅』から徒歩約5分

* 都営三田線・大江戸線『春日駅』から徒歩約7分 * JR総武線『水道橋駅』から徒歩約15分

* 会場 URL: <http://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/>

司 会：田中秀岳(上智大学)、長門毅(富士通研究所)

次 第：(予定)

時間	題 目	内 容	講 師
10:00～10:05	挨拶		
10:05～11:05	【基調講演】 ここまで定着した自動車のデジタル開発	1980年代から始まった「自動車開発のデジタル化」は、第一世代の「CAD/CAM一元化」、第二世代の「データ駆動プロセス改革」を経て、第三世代の「超短縮プロセス」が実現した。この定着した「デジタル開発」はさらに進化し「性能設計・制御設計のデジタル化」を実現しようとしている。	アドバンスソフト株式会社 顧問 加藤 廣
11:05～11:10	休憩		
11:10～12:10	3D製図(DTPD)規格(JIS B 0060シリーズ)の動向と自動車業界での適用例	2015年から制定され始めた10部構成となる予定のJIS B0060デジタル製品技術文書情報(DTPD)シリーズの趣旨・背景・経緯、さらに第1部：総則、第2部：用語、第3部：設計モデルの表し方および第4部：寸法及び公差の指示方法の概要を説明する。また、自動車工業会(JAMA/JAPIA)・電子情報産業協会(JEITA)における適用事例も紹介する。	関東学院大学 理工学部 理工学科 機械学系 教授 金田 徹
12:10～13:00	昼 食		
13:00～14:00	デジタルよりは、まず現場	日本中の機械工学専攻で、好きなものを設計して作るという演習が消滅しつつある。理由は簡単で、若い教員の研究を邪魔しないでくれ、という教授の圧力である。設計は面白い。デジタル漬けの彼らにこそ、若いうちに現場で何かを作るチャンスを与えよう。	東京大学 大学院 工学系研究科 機械工学専攻 教授 中尾 政之
14:05～14:10	休憩		
14:10～15:10	企業での技術人材育成に関する一考察	失われた20年の技術人材育成への影響と問題点、その克服策を各企業の事例を交えて紹介します。また、技術者に求められる基本スキルや育成方法に関してコンサル経験を踏まえ紹介します。	株式会社日本能率協会コンサルディング JMAC チーフコンサルタント 渡部 訓久
15:10～15:20	休憩		
15:20～16:20	金型作りのキモ「設計」の現状と課題と未来を考える	職人技と称される日本の型技術と情報技術は相容れるのか？金型設計から最終工程までを情報技術で連携する一例を示しつつ金型作りのキモ「設計」の現状と次の型作りに必要な課題を考察する。	株式会社ツバメックス 金型部 開発係 CAD/CAM システム担当 主任 荒井 善之
16:20～16:25	休憩		
16:25～17:25	金型における2D/3Dハイブリッド設計の有効活用	金型設計・製造において3次元データを有効活用したリードタイム短縮が主流となる一方で、他システムとの併用運用等、実際の現場では多くの課題に直面しているケースがあります。当社では、これらを単一システムで解決すべく、2D/3Dハイブリッド設計を実現する「EXCESS-HYBRID II」の事例を交えて紹介します。	株式会社 C&G システムズ 商品企画統括部 渡邊 忍
17:30～19:00	名刺交換会 交流会(参加費無料)		

主催：公益社団法人 精密工学会 企画：事業部企画第1グループ

協賛(予定)：SME日本支部/応用物理学会/大田区産業振興協会/型技術協会/軽金属学会/計測自動制御学会/コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)/品川区/自動車技術会/首都圏産業活性化協会/情報処理学会/TAMA-TLO/電気加工学会/電気通信協会/電子情報技術産業協会/電子情報通信学会/日本オプトメカトロニクス協会/日本金型工業会/日本機械学会/日本工学会/日本工作機械工業会/日本設計工学会/日本塑性加工学会/日本ソフトウェア科学会/日本鑄造工学会/日本デザイン学会/日本溶接協会/日本ロボット学会

*協賛団体にご所属の方は会員価格にてご参加いただけます。

定 員：60名(先着順で定員になり次第締切ります)

参加費：会 員(賛助会員および協賛団体会員を含む)22,000円、学生会員2,000円、非会員36,000円、学生非会員7,000円

【会員・学生会員・非会員・学生非会員とも講習会テキスト代含む】 *参加費・講習会テキスト代とも消費税を含みます。

*賛助会員参加無料券をお持ちの方は是非ご利用下さい。

資 料：講習会テキストのみ、または聴講者で2冊以上ご希望の場合、1冊5,000円

申込方法：ホームページ(https://www2.jspe.or.jp/form/koshukai/koshukai_form.html)からお申込み下さい。

申 込 先：公益社団法人 精密工学会(〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル2F、電話03-5226-5191、Fax03-5226-5192)